



Advance Materials Corporation

聯致科技股份有限公司

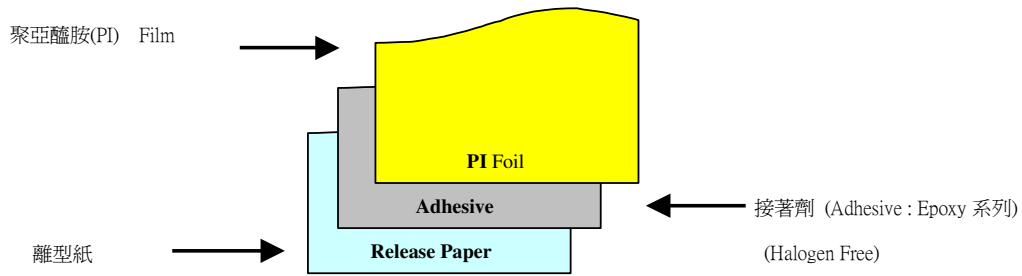
軟性印刷電路板材料

覆蓋膜產品技術資料

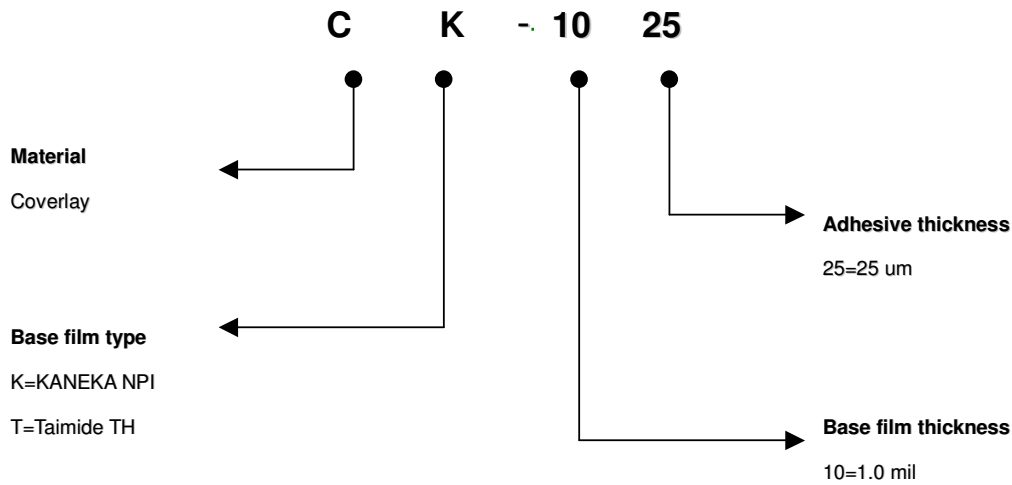
產品特性

1. 通過且符合 UL 各項測試認證產品。
2. 產品所含之 Halogen 含量經 SGS 測試，皆能符合國際規範小於 900ppm。
3. 尺寸安定性優異。
4. 耐環境可靠性測試能力佳(高溫高濕)。

產品組成



編碼原則



產品規格

產品型號	PI 膜厚度(mil)	膠厚(μm)	總厚度(μm)
Name	Thickness of Film (mil)	Thickness of Adhesive (μm)	Total Thickness (μm)
CK-0515	1/2	15	27.5
CK-0525	1/2	25	37.5
CK-1025	1	25	50
CK-1035	1	35	60

保存方式

覆蓋膜的黏膠為熱固性的產品，在壓合時會產生流動性進行填滿線路，達到驅趕氣泡與提高抗撕強度的功用。此流動性會隨保存環境與保存時間而異，爲了在壓合時達到可靠的流動性與抗撕強度，建議保存在 5°C 的環境中，並於三個月內使用。

產品認證

1. UL : E201676
2. SGS

FPC 快速壓合建議操作條件

1. 壓合溫度 : 180°C(一段溫)
2. 壓合壓力 :
 - a. 預壓段 ==> 0 kg/cm²
 - b. 成型段 ==> 80~100kgf/cm²
3. 壓合時間 :
 - a. 預壓段 ==> 5~10 sec
 - b. 成型段 ==> 120 sec

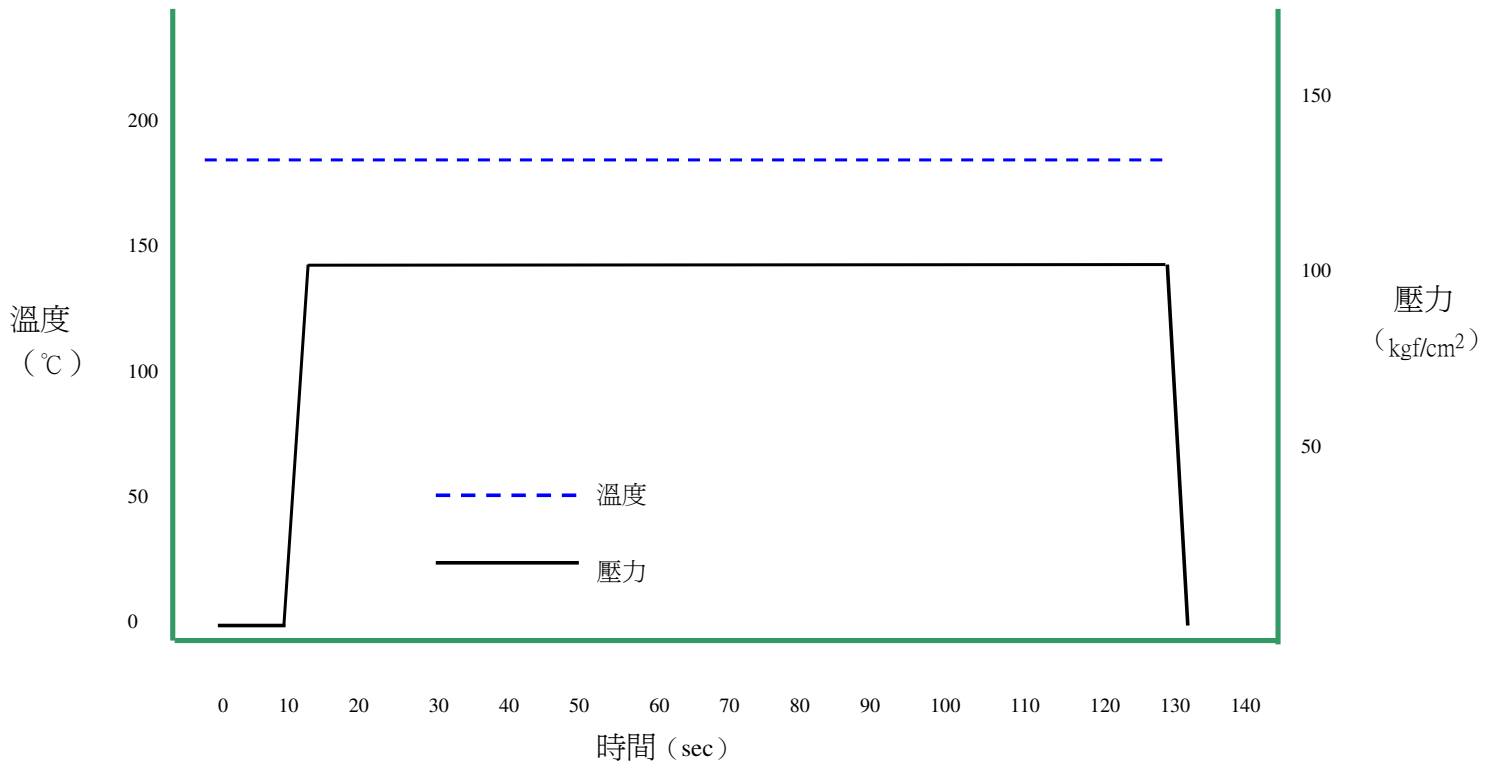
FPC 傳統平板壓合建議操作條件

1. 壓合溫度 : 160°C
2. 壓合壓力 :
 - a. 初段壓 ==> 35~40kgf/cm²
 - b. 高段壓 ==> 35~40kgf/cm²
3. 壓合時間 :
 - a. 初段壓 ==> 每分鐘 2~3°C 進行升溫
 - b. 高段壓 ==> 90min

備註：因各司機台設備及材料皆有差異，本司所提供之壓合條件僅供貴司參考，謝謝

FPC 快速壓合曲線圖

(壓合建議曲線圖)



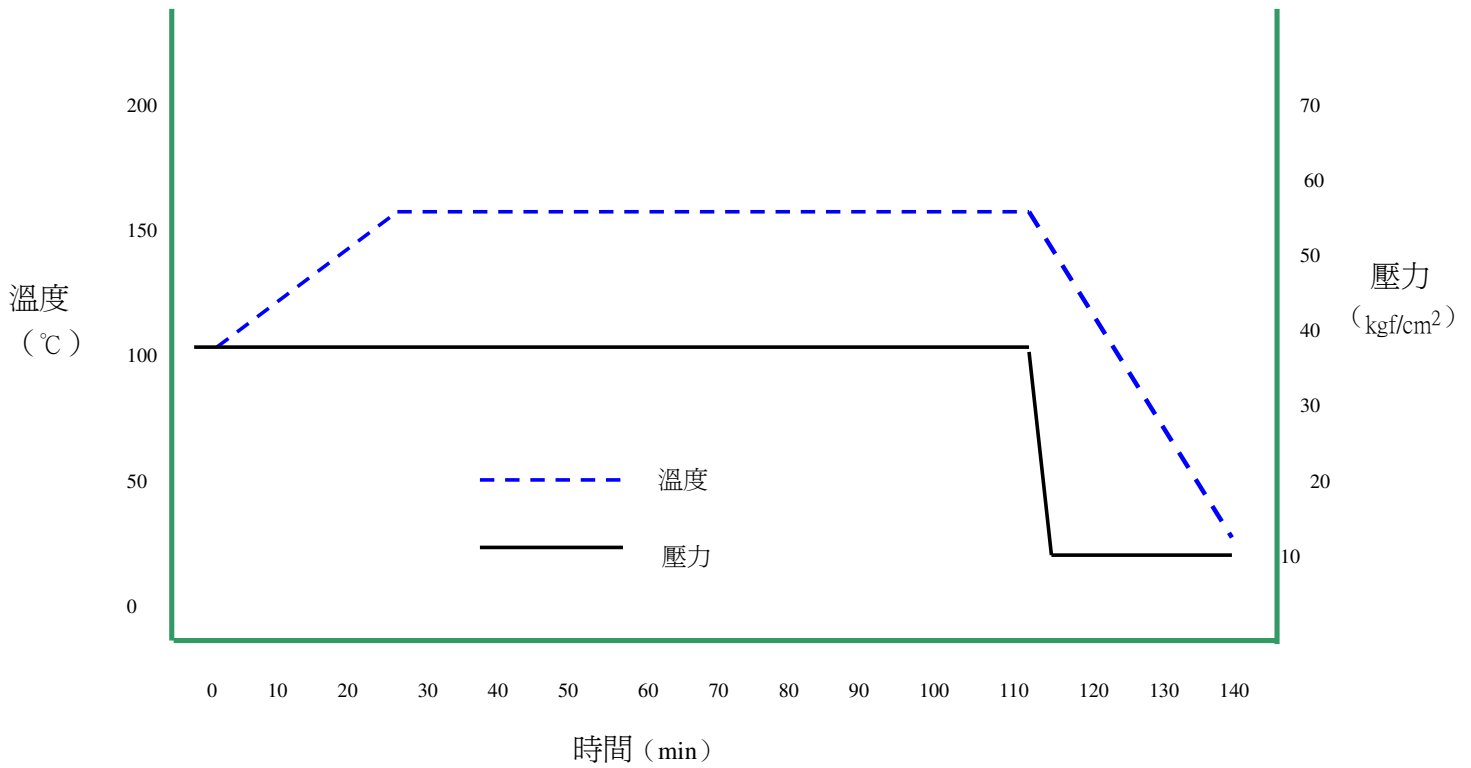
說明：

1. 於 180°C 下將待壓合成品置入，壓力為 0 kgf/cm²。
2. 進行預壓段，時間約為 5~10 秒。
3. 壓力升到 80~100 kgf/cm²，壓合約 80~120 秒。
4. 壓合後以 160°C 烘約 1~2 小時。

備註：因各司機台設備及材料皆有差異，本司所提供之壓合條件僅供貴司參考，謝謝

FPC 傳統平板壓合曲線圖

(壓合建議曲線圖)



說明：

1. 於溫度設定為 110~130°C 時將待壓品置入，壓力設定為 30~40 kgf/cm²。
2. 以每分鐘 2~3°C 的溫度升溫，持續升溫至 160°C。
3. 當溫度升溫至 160°C 後，維持 90 分鐘壓合時間。
4. 產品壓合完畢後，將產品進行冷壓，持續降溫。

備註：因各司機台設備及材料皆有差異，本司所提供之壓合條件僅供貴司參考，謝謝

材料基本特性標準

COVERLAY CK-0515

項目		標準說明	測試方式
PI film type		13 um	
Adhesive thickness		15 um	
Peel Strength	As received	0.9 kgf/cm 以上	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm 以上	
	85℃ /85%RH/96H	0.7 kgf/cm 以上	----
Dimensional stability	MD(%)	± 0.2%以下	IPC-TM-650 2.2.4
	TD(%)	± 0.2%以下	
Solder float		300℃ × 10 sec × 3 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Resion Flow		≤0.15mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Flammability		v0	UL 94
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Acton MEK	ALL PASS	
Shelf life		3 month / 5℃	

COVERLAY CK-0525

項目		標準説明	測試方式
PI film type		13 um	
Adhesive thickness		25 um	
Peel Strength	As received	0.9kgf/cm 以上	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm 以上	
	85℃ /85%RH/96H	0.7 kgf/cm 以上	----
Dimensional stability	MD(%)	± 0.2%以下	IPC-TM-650 2.2.4
	TD(%)	± 0.2%以下	
Solder float		300℃ x 10 sec x 3 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Resion Flow		≤0.15mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Flammability		v0	UL 94
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Acton MEK	ALL PASS	
Shelf life		3 month / 5℃	

COVERLAY CK-1025

項目		標準説明	測試方式
PI film type		25 um	
Adhesive thickness		25 um	
Peel Strength	As received	0.9kgf/cm 以上	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm 以上	
	85℃ /85%RH/96H	0.7 kgf/cm 以上	----
Dimensional stability	MD(%)	± 0.2%以下	IPC-TM-650 2.2.4
	TD(%)	± 0.2%以下	
Solder float		300℃ x 10 sec x 3 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Resion Flow		≤0.15mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Flammability		v0	UL 94
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Acton MEK	ALL PASS	
Shelf life		3 month / 5℃	

COVERLAY CK-1035

項目		標準説明	測試方式
PI film type		25 um	
Adhesive thickness		35 um	
Peel Strength	As received	0.9kgf/cm 以上	IPC-TM-650 2.4.9
	After Mek / 10 min	0.8 kgf/cm 以上	
	85℃ /85%RH/96H	0.7 kgf/cm 以上	----
Dimensional stability	MD(%)	± 0.2%以下	IPC-TM-650 2.2.4
	TD(%)	± 0.2%以下	
Solder float		300℃ × 10 sec × 3 cycle	IPC-TM-650 2.4.13
Dielectric constant		< 4.0	IPC-TM-650 2.5.5.3
Surface resistance		1.0E+13(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Volume resistance		1.0E+14(Ω)以上	IPC-TM-650 2.5.17
Resion Flow		≤0.15mm	IPC-TM-650 2.3.17.1
Flammability		v0	UL 94
Chemical resistance	10%HCL 10%NaOH Acton MEK	ALL PASS	
Shelf life		3 month / 5℃	